

Heat Sink Compound

Description générale

Pâte de dissipation thermique aux silicones. Efficace sur les composants électroniques.

Caractéristiques

- Conductivité thermique élevée
- Excellent tampon sur l'humidité.
- Faible teneur en impuretés métalliques.

Applications

- Circuits imprimés.
- Composants électroniques.
- Montages de contrôle.

Mode d'emploi

- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Pâteux.
Couleur	Blanc.
Odeur	Odeur caractéristique.
Densité	2.3 g/cm ³ (à 20°C).
Plage de température opérationnelle	-50 --> 300 °C

Remarques

Toutes les déclarations de cette publication sont basées sur l'expérience et / ou les tests en laboratoire. En raison de l'incidence des équipements, des conditions d'utilisation et facteurs humains pouvant être impliqués, nous recommandons que nos produits soient testés sur le lieu de travail avant utilisation. Toutes les informations sont données de bonne foi mais sans garantie ni explicite ni implicite. Cette fiche technique peut être révisée du fait d'un changement de législation, selon la disponibilité des composants ou au regard d'expériences nouvellement acquises. Il appartient au Client de s'assurer de son information permanente en s'inscrivant sur le site Internet officiel de CRC (<http://www.crcind.com>) afin de recevoir les mises à jour successives des documents techniques. Le site Internet officiel de CRC est gratuit, n'exige aucun achat préalable et assure une pleine confidentialité. Aucune pénalité ou aucune somme de quelque nature que ce soit ne pourra être



Technical Data Sheet

Heat Sink Compound

appliquée, déduite, compensée ou facturée à CRC pour modification d'un document dans les conditions qui précèdent.

Version

KOC-HEAT_SINK_COMPOUND-20180828

Date

28/08/2018